



Crossing Automation 進軍 18 吋半導體製造市場； 接獲全新 Spartan™ 450 分類機的訂單

加州，費利蒙——2011 年 9 月 26 日——廣受現今首要半導體裝置及設備公司青睞的晶圓廠與機台自動化產品領導設計商暨製造商 Crossing Automation Inc. (www.crossinginc.com)，今日推出其 18 吋分類機——Spartan™ 450。同時，該公司宣布其全新分類機已接獲一半導體領導龍頭的訂單。此平台預估將於 2012 年第一季出貨。

Gartner 研究總監 Samuel Tuan Wang 指出：「18 吋晶圓對半導體廠商深具吸引力，因為整個矽晶表面部分及其良率均較小尺寸的晶圓來得大。近幾年來，12 吋晶圓發展蓬勃，已取代 8 吋晶圓，成為晶圓技術的主流。由 12 吋晶圓邁入 18 吋晶圓將使晶片生產力加倍，且半導體產業將有機會持續茁壯成長。」*

Crossing Automation 的 Spartan 450 分類機為市場首批專門生產 18 吋晶圓的大型分類機。它融合所有關鍵功能以與製造執行系統 (MES) 接合，進而啟用全方位晶圓管理。它初期鎖定 22 奈米技術節點，可縮小至 7 奈米節點。全新分類機的設計採用經生產驗證的 Crossing 12 吋 Spartan 平台，至今已有逾 1,000 個系統應用在高產量的製造上。與 12 吋 Spartan 相同，18 吋分類機以單機、整合單位設計，可更快達成機台安裝與工具連結，移動更簡便，提高靈活性，加速極致生產率。

Crossing Automation 行銷副總經理 May Su 表示：「Crossing Automation 長久以來致力於產品發展的投資，以滿足全新與新興市場，而 18 吋晶圓製造也不例外。憑藉在交付經驗證的自動化解決方案方面的悠久歷史，我們脫穎而出。」

關於 Crossing Automation

Crossing Automation 為晶圓廠與機台自動化產品的領導設計商暨製造商，專門處理現今半導體裝置及設備公司面臨的關鍵問題。公司透過持續交付快速、可靠的 8 吋與 12 吋晶圓以及由精密控制軟體支援的載體輸送產品，提升晶圓廠生產力並降低設備成本。Crossing 中產品多樣的大氣及真空模組包含晶圓載入機、設備前端模組 (EFEM)、分類機、真空晶片傳輸裝置 (vacuum transfer chamber)、FOUP 晶圓傳送盒緩衝組、RFID 系統與承載追蹤軟體。上述解決方案以多種配置方式解決客戶需求，達到極大化的彈性。如欲了解更多資訊，請訪問 www.crossinginc.com。

*Gartner, Inc.，新興科技分析 (Emerging Technology Analysis)：2011 年 8 月 5 日，Samuel Tuan Wang，半導體產業逐漸投入 18 吋晶圓生產之因 (Why the Semiconductor Industry Is Moving Closer to 450 mm Production)。

公司聯絡人

May Su

行銷副總經理

Crossing Automation

510 661 5009

may.su@crossinginc.com

代理聯絡人

Amy Smith

Impress Labs

401 369 9266

amy@impresslabs.com